

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成20年9月4日 (2008.9.4)

【公表番号】特表2004-502164(P2004-502164A)
 【公表日】平成16年1月22日 (2004.1.22)
 【年通号数】公開・登録公報2004-003
 【出願番号】特願2002-506066(P2002-506066)
 【国際特許分類】

G 0 1 N 1/00 (2006.01)

C 1 2 M 1/00 (2006.01)

G 0 1 N 1/28 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 1/00 1 0 1 H

C 1 2 M 1/00 A

G 0 1 N 1/28 K

【手続補正書】
 【提出日】平成20年6月30日 (2008.6.30)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 サンプル材料の処理に用いる装置において、
 第 2 側に取り付けられた第 1 側を備える本体と、
 前記第 1 側と前記第 2 側との間に形成されるプロセスアレイであって、装填構造体、長さを有する主導管、および該主導管に沿って分散配置される複数のプロセスチャンバを備え、該装填構造体が該主導管を経由して該複数のプロセスチャンバに流体連通しているプロセスアレイと、
 前記装填構造体と前記複数のプロセスチャンバとの間に配置される変形可能なシールと、
 を具備することを特徴とする装置。

【請求項 2】 サンプル材料の処理に用いる装置において、
 第 2 側に取り付けられた第 1 側を備える本体と、
 前記第 1 側と前記第 2 側との間に形成されるプロセスアレイであって、装填構造体、長さを有する主導管、および該主導管に沿って分散配置される複数のプロセスチャンバを備え、該主導管が該装填構造体および該複数のプロセスチャンバに流体連通しているプロセスアレイと、
 を具備し、

前記複数のプロセスチャンバが、前記主導管の第 1 側に位置する第 1 プロセスチャンバグループと、前記主導管の第 2 側に位置する第 2 プロセスチャンバグループとを備え、

前記第 1 プロセスチャンバグループの各プロセスチャンバが、第 1 フィーダ導管を経由して前記主導管と連通し、前記第 2 プロセスチャンバグループの各プロセスチャンバが、第 2 フィーダ導管を経由して前記主導管と連通し、

前記第 1 フィーダ導管が前記主導管に対して 90 度未満の第 1 フィーダ導管角度を成し、前記第 2 フィーダ導管が前記主導管に対して 90 度未満の第 2 フィーダ導管角度を成し、

前記第 1 フィーダ導管角度が前記第 2 フィーダ導管角度と異なること、

を特徴とする装置。

【請求項 3】 サンプル材料を処理する方法において、

第 2 側に取り付けられた第 1 側を備える本体と、前記第 1 側と前記第 2 側との間に形成されるプロセスアレイであって、装填構造体、長さを有する主導管、および該主導管に沿って分散配置される複数のプロセスチャンバとを備え、該主導管が該装填構造体および該複数のプロセスチャンバに流体連通しているプロセスアレイと、前記装填構造体と前記複数のプロセスチャンバとの間に配置される変形可能なシールとを具備するサンプル処理装置を用意することと、

前記主導管を経由して前記プロセスチャンバの少なくとも幾つかにサンプル材料を分配することと、

前記変形可能なシールを閉じることと、

前記本体を熱ブロックに接触させて配置することと、

前記本体が前記熱ブロックと接触している間に該熱ブロックの温度を制御することと、を含むことを特徴とする方法。